



#1 Coating Technology in The World
Molecule Gradient Layer (MGL)TM Technology

耐熱イミド基材マスキング・半導体チップ固定用テープ

170 シリーズ

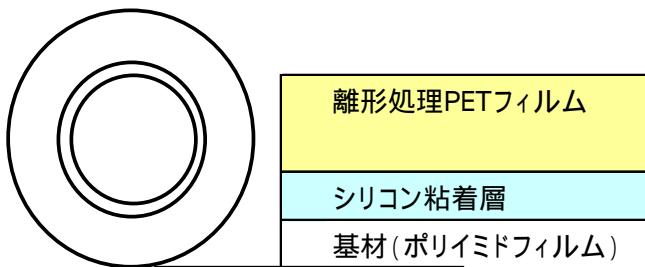
特徴

半田耐熱性ポリイミドフィルムを基材にした耐熱テープ
ガラス・半導体への糊残り性に優れている。(171)
軽剥離性(171)、強粘着性(172、174)のグレードを用意

用途

- 171 C-MOSカメラモジュール用ガラス、C - MOSへのマスキングテープ
- 175 C-MOSカメラモジュール用ガラス、C - MOSへのマスキングテープ
- 172 リードフレーム(仮)固定テープ (中粘着)
- 174 リードフレーム(仮)固定テープ (強粘着)

構造



特性

一般特性

製品名	厚み (mm)	(基材厚み) (mm)	粘着力 (N/25mm)
171	0.065	0.050	0.1
175	0.040	0.025	0.2
172	0.040	0.025	3
174	0.065	0.050	5
KX174 (開発品)	0.050	0.025	8

測定条件 引張速度 300mm/min
(JIS Z0237準拠) 引張角度 180度 貼り合わせ後、24時間後の測定値
測定温度 23 被着体 ステンレス板

製品名	(基材厚み) (mm)	引張強度 (MPa)	伸び (%)	絶縁破壊電圧 (KV/mm)
171	0.050	310	80	18
175	0.025	340	60	9
172	0.025	340	60	9
174	0.050	310	80	18

試験条件 C2318 C2318 C2318

【171・175系】

ガラス・半導体・回路エッチング用耐熱マスキング

(1)のり残り性

171



一般イミドテープ



条件

ガラスに貼りつけ後、250℃ 1分放置

取り出した後、室温30分空冷。テープをとり、ガラス面を観察

(2)耐薬品性

pH = 2の酸性溶液(H₂SO₄水溶液)の中に1分間浸漬させる。

【試験前】



【試験後】



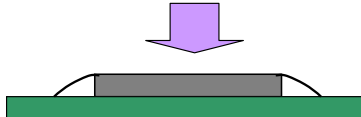
耐酸性が良好である。

マスキング工程への応用例

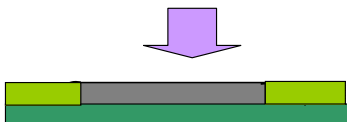
(1)CMOS形成



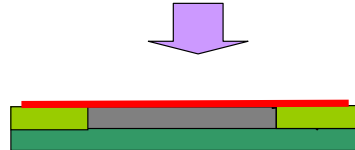
(2)ワイヤーボンディング



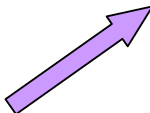
(3)樹脂モールド(樹脂封止) : CSP



(4)マスキングテープ貼り

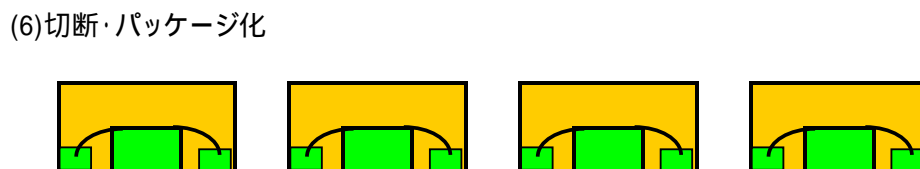
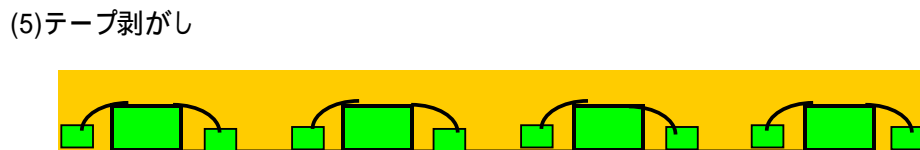
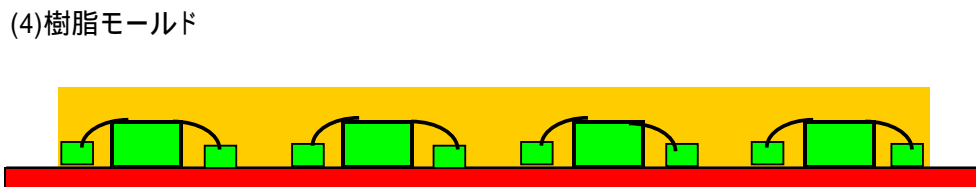
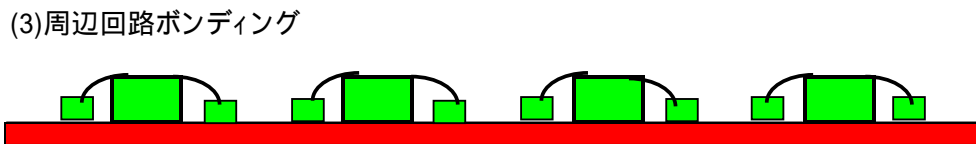
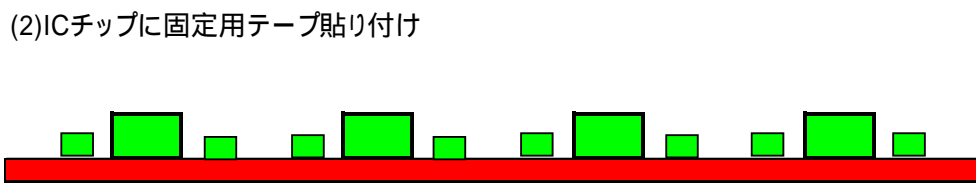
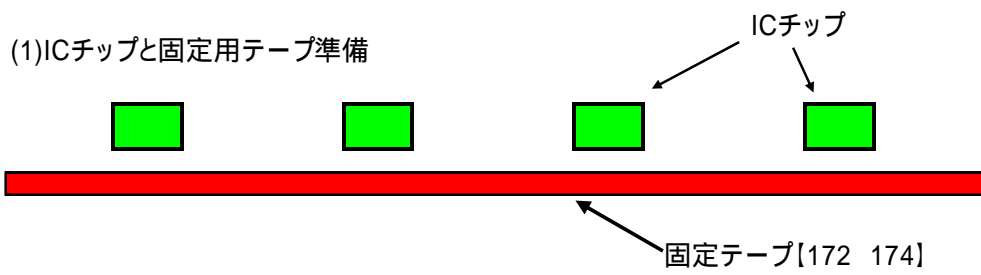


リフロー工程



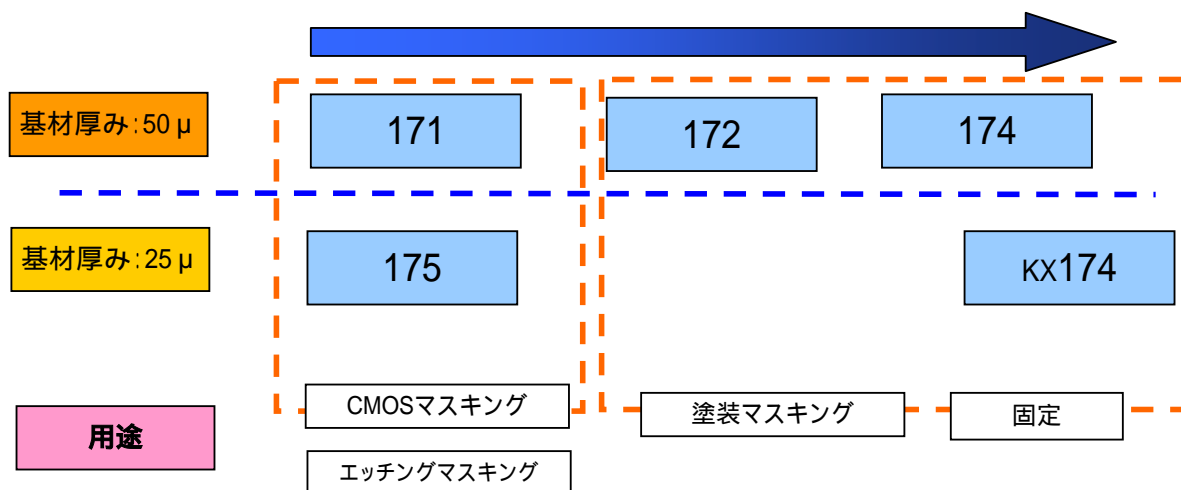
【172・174系】

ICパッケージ成型時の固定テープ



品番の選定

粘着	弱い	強い
のり残り	なし	やや多い



ご使用上の注意

技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。

但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。

したがってこれらの特性データにつきましては参考値であり、保証値ではありません。

ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。

上記測定は、室温(23)下にて行われたデータです。低温(5 以下)の場合、粘着力は、急激に低下する場合があります。

保管の注意

必ず箱に入れて保管してください。

保管場所は、直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。

特に、高温高湿下(温度30 以上 湿度50%以上厳禁)にさらさないでください。

2010年12月8日 発行

共同技研化学株式会社
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井940番地
04-2944-5151